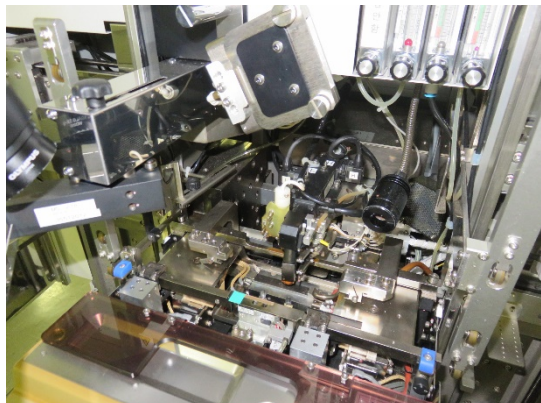


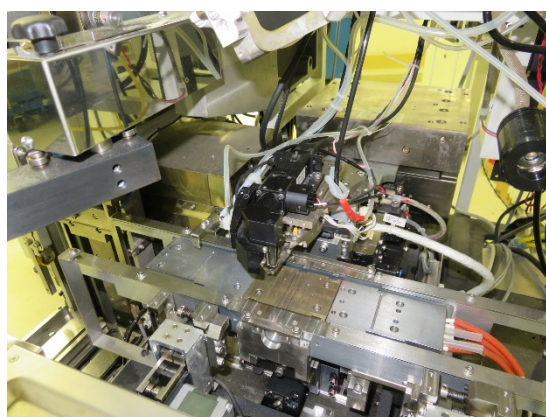
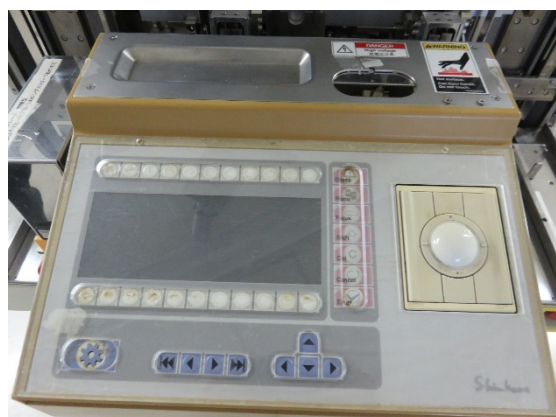
USED FPD Equipment Information

No.	Name	Maker	Type	Quantity
1	Wire Bonder	新川	UTC-1000 Super	20台
2	Wire Bonder	新川	ACB-1000	1台
3	Wire Bonder	新川	ACB-3000	5台



名称/NAME	ワイヤーボンダー/Wire Bonder
メーカー/Maker	(株)新川/SHINKAWA LTD
型式/Type	UTC-1000Super
年式/Data	2006年製
台数/Quantity	20台

仕様	<p>対象資料 品種: IC, LSI 及び BGA 等の基板(リードフレーム型) 幅: 20~80mm 長さ: 95~262mm 厚さ: (1)一般リードフレーム 0.07~0.3mm (2)幅広銅フレーム 0.07~0.16mm (3)薄型基板 0.3~0.5mm (4)厚型基板 0.5~0.7mm (5)搬送用キャリア 1.0~2.0mm※品種毎に専用</p> <p>ワイヤー: 金線 $\Phi 15\sim 38\mu\text{m}$ 2インチ両フランジスプール使用</p> <p>機能(参考) ボンディング方式: 超音波熱圧着によるAu線ボンディング ボンドスピード: 67ms/2mmワイヤ ワイヤ長: MAX8mm ワイヤ曲がり: 50μm以内/ワイヤ長4.5mm ボンドエリア: X=±28mm Y=±33mm ボンディング精度: ±2.5μm(3σ) 荷重時間: 3~150ms(0.1ms/step) ボンド荷重: 30~2940mN(1mN/step) サーチスピード: 1~80mm/s(0.1mm/s step) ボンディング位置の設定: セルフティーチング方式</p> <p>ローダ/アンローダ部 マガジンサイズ: 幅 23~90mm 長さ 110~265mm 各方向移動ピッチ: 10μm/step</p> <p>ワークフィーダ部 搬送方式: デジタル式クランプ送り方式 送りピッチ: MAX71mm(5μm/step)</p> <p>ヒートブロック加熱範囲: 室温~300°C</p> <p>外観寸法: W1100 * D950 * H2000 重量: 約600kg 電源: 単相 AC100V 50/60Hz 圧空: 0.5Mpa 60L/min 真空: -74kpa</p>
----	---



名称/NAME	ワイヤーボンダー/Wire Bonder
メーカー/Maker	(株)新川/SHINKAWA LTD
型式/Type	ACB-1000
年式/Data	2004年製
台数/Quantity	1台

※出荷時には、付属品/外板は復旧した状態に致します。



仕様

対象資料

品種: 小信号トランジスタ、ダイオード(フープフレーム型)

幅: 8~60mm

厚さ: 0.07~0.3mm

ワイヤー※金線、2インチ両フランジスプール使用

(1)Φ15~38μm (2)Φ20~50μm (3)30~70μm

機能(参考)

ボンディング方式: 超音波熱圧着によるAu線ボンディング

ボンディングスピード: 65ms/0.7mmワイヤ

ワイヤ長: MAX8mm

ワイヤ曲がり: 50μm以内/ワイヤ長2.0mm

ボンディングエリア: X/Y=66mm-カメラオフセット

ボンディング精度: ±3.5μm(フォーミングガス使用時は±4.5μm)

荷重時間: 3~150ms(0.1ms/step)

ボンディング荷重: 30~2940mN(1mN/step)

サーチスピード: 1~80mm/s(0.1mm/s step)

ボンディング位置の設定: セルフティーチング方式

ワークフィーダ部

搬送方式: デジタル式ピン送り方式

送りピッチ: MAX71mm(5μm/step)

リードフレーム加熱範囲: 室温~350°C

外観寸法: W900 * D1050 * H2000

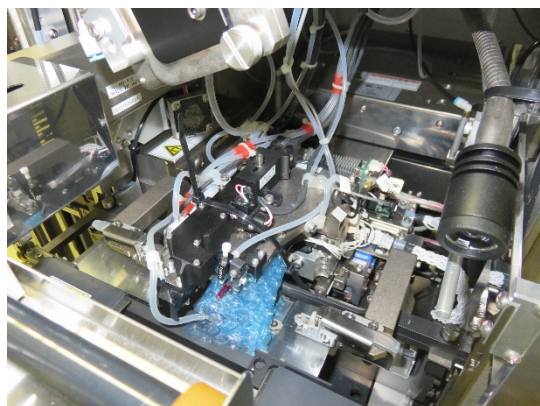
重量: 約670kg

電源: 単相 AC100V 50/60Hz

圧空: 0.5Mpa 60L/min

真空: -74kpa

フォーミングガス: 200kPa 10L/min



名称/NAME	ワイヤーボンダー/Wire Bonder
メーカー/Maker	(株)新川/SHINKAWA LTD
型式/Type	ACB-3000
年式/Data	2011年製
台数/Quantity	5台

仕様

対象資料

品種: 小信号トランジスタ、ダイオード等の小型ダイ
リードフレーム

幅: ユニバーサル20~92mm 密閉8~60mm

長さ: ユニバーサル/密閉共通 95~262mm

厚さ: ユニバーサル0.1~0.3mm 密閉0.1~0.5mm

ワイヤー: 金線 $\Phi 15\sim 38\mu\text{m}$ 2インチ両フランジスプール使用

機能(参考)

ボンディング方式: 超音波熱圧着によるAu線ボンディング

ボンディング速度: 50ms/0.7mmワイヤ

ワイヤ長: MAX4mm

ワイヤ曲がり: 50 μm 以内

ボンディングエリア

Xボンディングエリア: ユニバーサル/密閉共通66mm -カメラオフセット4~10mm

Yボンディングエリア: ユニバーサル80mm 密閉70mm -カメラオフセット6~12mm

ボンディング精度: $\pm 3.5\mu\text{m}$ (フォーミングガス使用時は $\pm 4.5\mu\text{m}$)

荷重時間: 3~150ms(0.1ms/step)

ボンディング荷重: 30~2940mN(1mN/step)

サーチ速度: 1~80mm/s(0.1mm/s step)

ボンディング位置の設定: セルフティーチング方式

ローダ/アンローダ部

マガジンサイズ: 幅 23~102mm 長さ 110~265mm

各方向移動ピッチ: 10 μm /step

ワークフィーダ部

搬送方式

ユニバーサル: デジタル式クランプ方式

密閉: デジタル式ピン送り方式

送りピッチ: MAX71mm(5 μm /step)

ヒートブロック加熱範囲: 室温~320 $^{\circ}\text{C}$

(フォーミングガス使用時加熱範囲: 室温~300 $^{\circ}\text{C}$)

外観寸法: W1100 * D1000 * H2050(mm)

重量: 約550kg

電源: 単相 AC100V 50/60Hz

圧空: 0.5Mpa 90L/min

真空: -74kpa

フォーミングガス: 200kPa 10L/min